

## 9. 高周波線路の電流分布特性

### 1. 目的

高周波帯における信号伝送特性について理解するため、プリント線路上の磁界測定から電流を推定し、定在波分布について考察する。

### 2. 高周波帯における線路上の電流分布

#### 2-1. 分布定数回路における電圧と電流

高周波を扱う回路では、信号波長の大きさによって集中定数回路と分布定数回路に分けられる。ある信号の周波数を  $f$ 、信号の伝搬速度を  $v$  とすると、波長  $\lambda$  は以下の式で表される。

$$\lambda = \frac{v}{f} \quad (1)$$

波長  $\lambda$  よりも十分に短い線路を集中定数回路、波長  $\lambda$  と同等もしくは短い線路を分布定数回路として取り扱う。

伝送線路には、平行銅線や同軸ケーブルなど、様々な形のものがある。導体には抵抗やインダクタ成分などの寄生成分が存在する。導体間にはキャパシタ成分や、微小な漏れ電流も考えられる。単位長さ当たりの抵抗  $R$ 、インダクタンス  $L$ 、線間のキャパシタ  $C$ 、コンダクタンスを  $G$  とする。代表的な平行導線について、微小区間ごとに区切り寄生成分やそれによる電圧の変化について考える。分布定数線路内における寄生成分を図1に示す。ここで、 $v_s$  および  $50\Omega$  は入力電圧と入力抵抗であり、 $Z_L$  は終端負荷である。

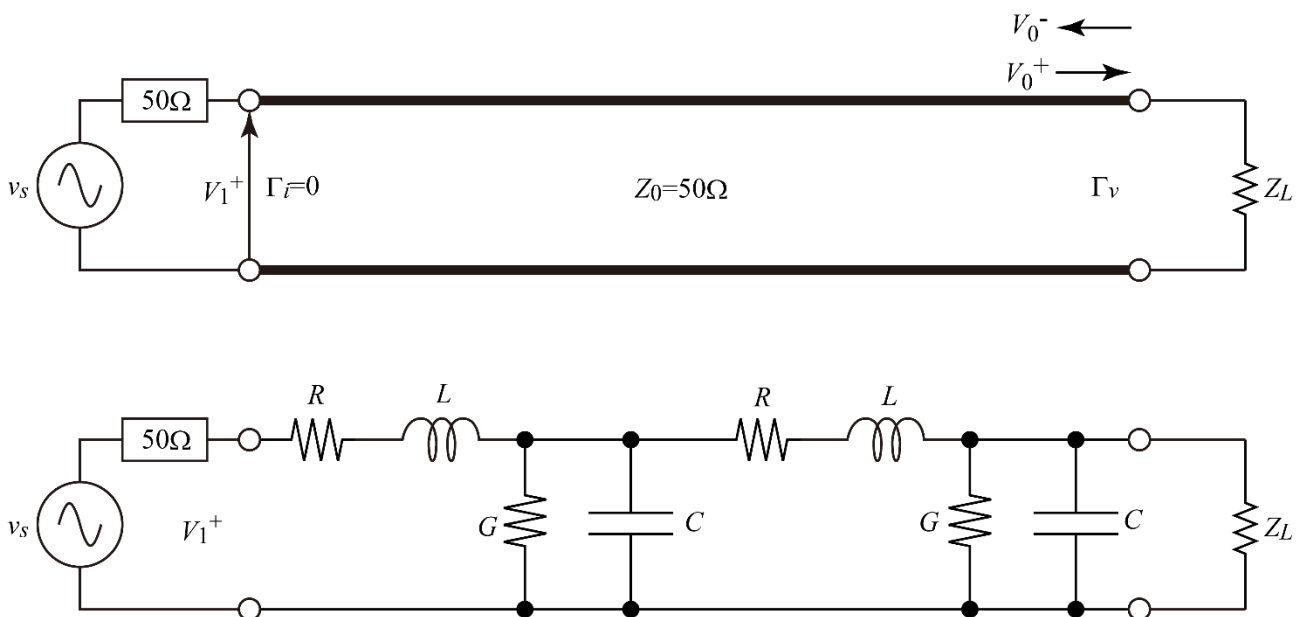


図1 伝送線路と RLGC モデル

伝送線路内を伝搬する伝搬定数は

$$\boldsymbol{\gamma} = \mathbf{ZY} = (\mathbf{R} + j\omega\mathbf{L})(\mathbf{G} + j\omega\mathbf{C}) \quad (2)$$

として表される。一方、特性インピーダンス  $Z_0$  は以下の式により求められ、無損失線路では  $L$  と  $C$  のみで表される。

$$Z_0 = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}} \cong \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (3)$$

伝送線路を伝搬する信号は、進行波と反射波の合成により成り立つ。式(4)に距離  $x$  における電圧と電流を示す。

$$\begin{cases} V(x) = \frac{V_1 - Z_0 I_1}{2} e^{+\gamma x} + \frac{V_1 + Z_0 I_1}{2} e^{-\gamma x} \\ I(x) = -\frac{V_1 - Z_0 I_1}{2Z_0} e^{+\gamma x} + \frac{V_1 + Z_0 I_1}{2Z_0} e^{-\gamma x} \end{cases} \quad (4)$$

ここで、 $e^{+\gamma x}$  の項は進行波を表しており、 $e^{-\gamma x}$  の項は反射波を表している。オイラーの公式

$$\begin{cases} \frac{e^{+\gamma x} + e^{-\gamma x}}{2} = \cosh \gamma x \\ \frac{e^{+\gamma x} - e^{-\gamma x}}{2} = \sinh \gamma x \end{cases} \quad (5)$$

を用いると、伝送線路の基礎方程式は式(6)のように表される。

$$\begin{pmatrix} V(x) \\ I(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh \gamma x & -Z_0 \sinh \gamma x \\ -\frac{1}{Z_0} \sinh \gamma x & \cosh \gamma x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1 \\ I_1 \end{pmatrix} \quad (6)$$

線路終端において、特性インピーダンス  $Z_0$  と終端負荷  $Z_L$  が不整合の場合、進行してきた波は  $Z_L$  で吸収されず反射する。反射係数は式(7)により表される。

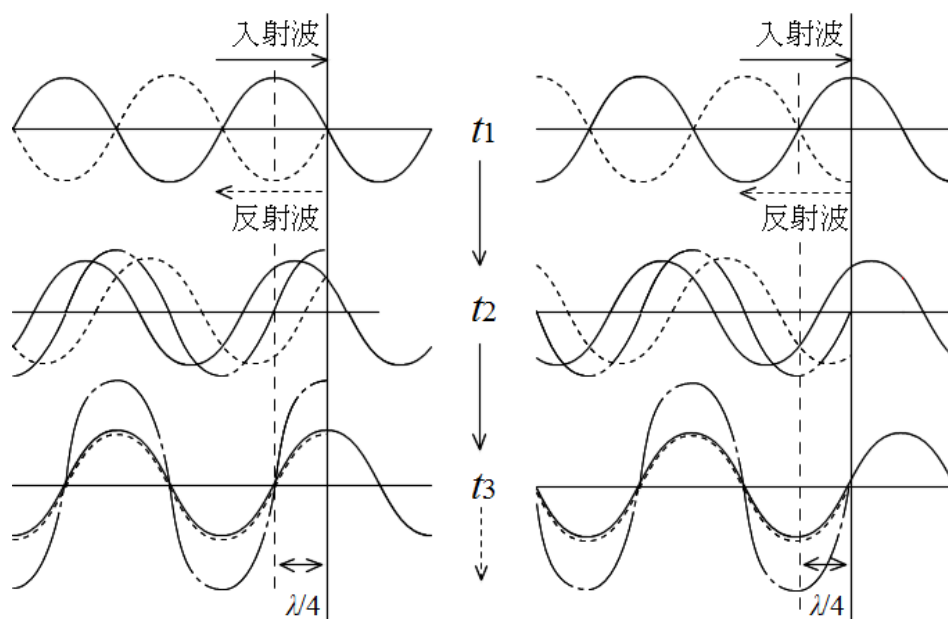
$$\Gamma_L = \frac{v_o^-}{v_0^+} = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \quad (7)$$

反射係数を用いて、距離  $x$  における電圧と電流は式(8)、(9)となる。

$$|V(x)| = |v_i| |1 + |\Gamma| e^{-j(\phi + 2\beta x)}| \quad (8)$$

$$|I(x)| = \frac{|v_i|}{Z_0} |1 - |\Gamma| e^{-j(\phi + 2\beta x)}| \quad (9)$$

終端の負荷条件により、反射波の大きさが変化する。例えば、終端開放の場合は反射係数  $\Gamma_L=1$  となり、正の波が反射する。一方、短絡の場合は、反射係数  $\Gamma_L=-1$  となり、負の波が反射する。反射波は進行波と合成され、定在波が分布する。図2にそれぞれの波の反射による定在波の分布を示す。



(a)反射係数 = 1

(b)反射係数 = -1

図2 入射波と反射波の時間変化による定在波の変化

特性インピーダンスとの不整合は、負荷へのエネルギー供給効率の低下となり、定在波はコモンモードによるノイズ放射の原因となり、高周波（MHz～GHz）帯で対策が必要となる。

## 2-2. マイクロストリップ線路

高周波回路にはプリント基板が用いられる。裏面が全面銅箔（GND）で、表面に信号線路がある基板をマイクロストリップ線路という。図3に示すマイクロストリップ線路における特性インピーダンスは、

$$Z_0 = \frac{87.0}{\sqrt{\epsilon_r + 1.41}} \ln \left( \frac{5.98H}{0.8W + T} \right) \quad (10)$$

により求められる[1]。ここで、Wは線路幅、Hは基板の厚さ、Tは線路銅箔の厚さ、 $\epsilon_r$ は比誘電率であり、ガラスエポキシ基板の比誘電率 $\epsilon_r$ は4.4（公称）である。

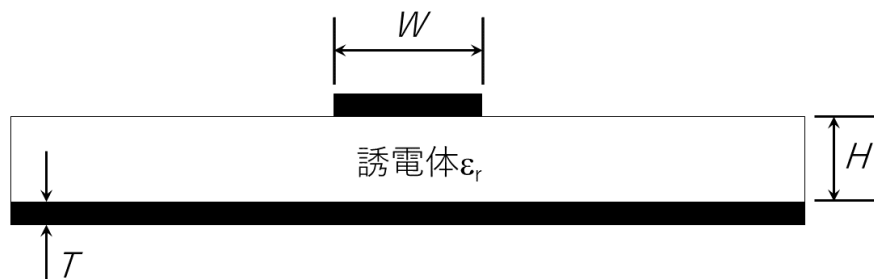


図3 マイクロストリップ線路の特性インピーダンスに用いる変数

### 2-3. 近磁界プローブ

プリント基板上の電流分布は、構造上の問題から直接測定することができない。このため、プリント線路上の磁界を測定することで、等価的に電流分布を推定する方法が用いられる。

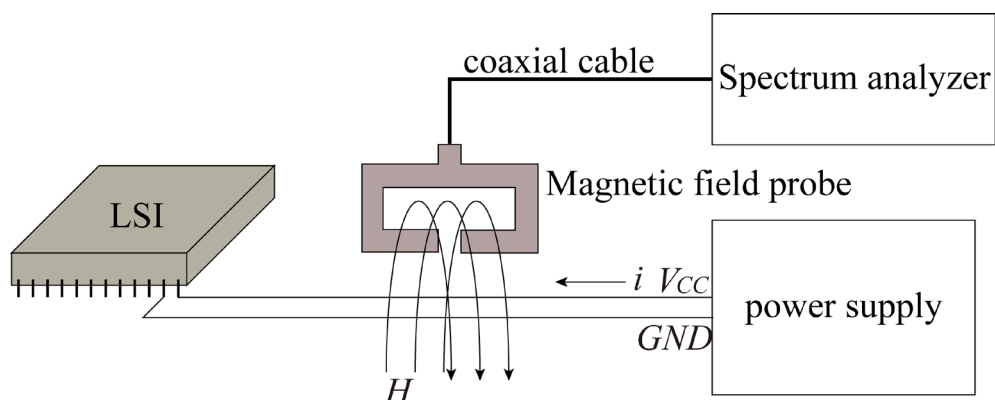


図4 磁界プローブによる近傍磁界の測定概要図

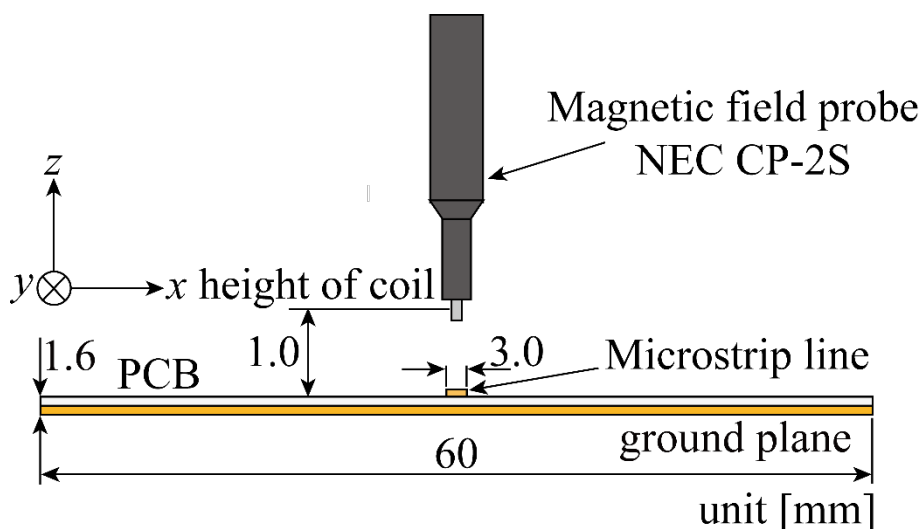


図5 測定系(断面)

線路から発生した磁界が磁界プローブに鎖交することで、プローブ端に誘導起電力が発生する。この検出電圧  $V$  をスペクトラムアナライザで測定することで、磁界測定が可能となる。磁界プローブは、波長よりも十分短い微小磁界プローブが一般的に用いられる。これは、広帯域で連続的磁界測定が可能となるためである。

スペクトラムアナライザで測定される値は検出電圧  $V$  であるため、磁界  $H$  に換算する必要がある。電圧  $V$  に図6に示すアンテナ係数 ( $AF$ ) を掛け合わせることで磁界  $H$  に変換できる[2]。

$$H = AF \cdot V \quad [\text{A/m}] \quad (11)$$

電磁界測定の場合、測定値は  $\text{dB}$  で測定する場合が多いため、 $\text{dB}$  表記では式(12)のようになる。

$$H = AF + V \quad [\text{dB}\mu\text{A/m}] \quad (12)$$

$$\text{dB}\mu\text{V} = 20 \log_{10}(\text{V}/1\mu\text{V}) \quad [1\mu\text{V} \text{ に対する信号比}]$$

$$\text{※dB} = 20 \log_{10}(\text{Vo}/\text{Vi})$$

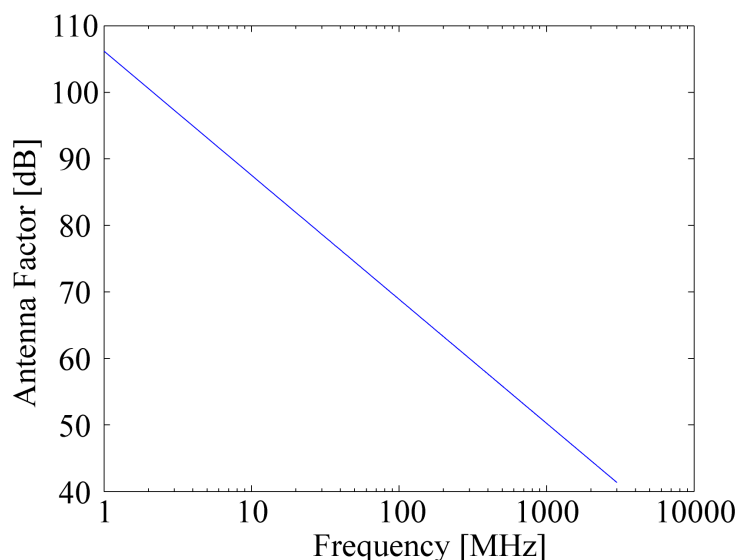


図 6 磁界プローブのアンテナ係数

#### 4. 実験方法

- (1) 使用機器を揃える。

スペクトラムアナライザ，磁界プローブ（NEC：CP-2S），3 軸ステージ，  
プリント基板，同軸ケーブル（× 2）

- (2) 3 軸ステージの同軸ケーブルに磁界プローブをセットする。同軸ケーブルはスペクトラムアナライザの RFIN に接続する。
- (3) 3 軸ステージにプリント基板（開放）を設置する。プリント基板の SMA コネクタとスペクトラムアナライザの TG を同軸ケーブルに接続する。
- (4) スペクトラムアナライザを以下の通りセットする。

Center Frequency：1 GHz    Span：10 MHz    BW：10 kHz    Sweep：auto

Reference：(最初の確認作業では) 107 dB $\mu$ V，

(測定時は) 87 dB $\mu$ V に変えて，Pre amp. を ON，

Attenuation：0 dB，TG 出力：107 dB $\mu$ V。

- (5) 磁界プローブをプリント線路終端位置にあわせる。この際，100mm 移動させるため，3 軸ステージの x 軸を右側に移動させておくこと。また，プローブ先端は基板上 1mm になるようにセットする。※プリント線路の両端の高さを可能な限り同じ高さに（水平に）する。0.1 mm 以下のずれにすること。
- (6) 5mm 間隔でデータを読む。ただし，定在波の節の部分は細かく読むこと。
- (7) プリント基板（短絡），（整合），（負荷）に交換して同様の実験を行う。
- (8) 測定値にアンテナ係数 AF をかけて磁界に変換する。

ここで、校正係数は次式で表される[2]。

$$AF = -8.1 \ln f + 106.2$$

※ $f$ は MHz オーダーで計算すること。例) 1GHz は  $f=1000$  で計算する。

## 5. 報告事項

- (1) 測定結果より波長 $\lambda$ ，伝搬速度 $v$ を算出なさい。速度 $v$ が光速よりも遅くなる理由について述べなさい。
- (2) プリント基板（負荷）の結果より，定在波比 **SWR** を求めなさい。
- (3) 反射係数 $\Gamma$ を求めなさい。また，接続した負荷抵抗の値を算出なさい。
- (4) 終端開放と短絡させた線路の入力インピーダンスを導出なさい。両者を掛け合わせることで線路の特性インピーダンスが求められることを証明なさい。

## 参考文献

[1]Mark I. Montrose 著，出口・田上共訳，プリント基板の EMC 設計，P.95，オーム社.

[2]磁界プローブ CP-2S 取扱説明書，NEC